



TWSE STOCK CODE 1560



中砂公司第四季法說會

凱基證券

2024/02/27



中砂投資人服務信箱
ir@kinik.com.tw

WWW.KINIK.COM.TW

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊，係本公司基於公司資料及現況所得之資訊。
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於原物料成本增加、市場需求，各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
- 對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不保證本簡報資料之正確性，且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。



報告事項

- **Welcome**

William Lee 李偉彰, 事業部總經理 / 發言人
Tony Pai 白景中, 副總經理 / 代理發言人
- 公司簡介
- 2023 第四季 & 2023全年度營運概況.
- 近期重要事件概況
- 2024 Outlook
- Q & A
- 附件: 中砂願景, 核心技術及產品, 廠區資訊



中砂公司簡介

- 成立於1953年; 2005股票上市, TWSE 股票代號 1560
- 實收資本額 (2023/2/23): 新台幣 14.4億
- 員工人數: 全球 ~2200人. 台灣 ~1800人. 工廠: 台灣*5, 泰國*1
- 2023合併營收 63.8億 TWD, EPS=5.91
- 2023年三大事業部主要產品及佔總營收比率.

ABU 砂輪事業部(鶯歌廠)

+ 子公司: KTC(泰國), 鴻記(台灣)

營收佔比 20%



傳統磨料及鑽石砂輪
(機械與工具機業..)

DBU 鑽石事業部

(鶯歌&樹林&湖口廠)

29%

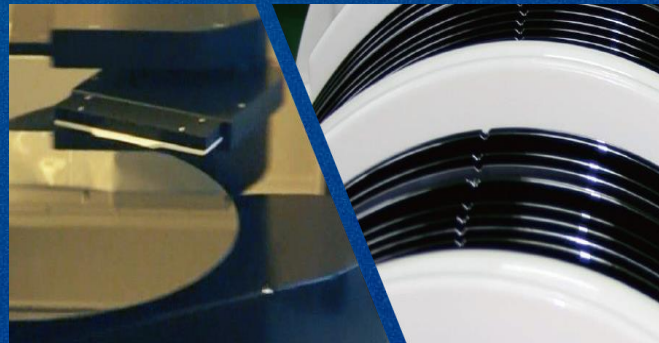


CMP 鑽石碟
(半導體業)

SBU 晶圓事業部

(竹北&竹南廠)

52%



測試及再生矽晶圓
(半導體業)



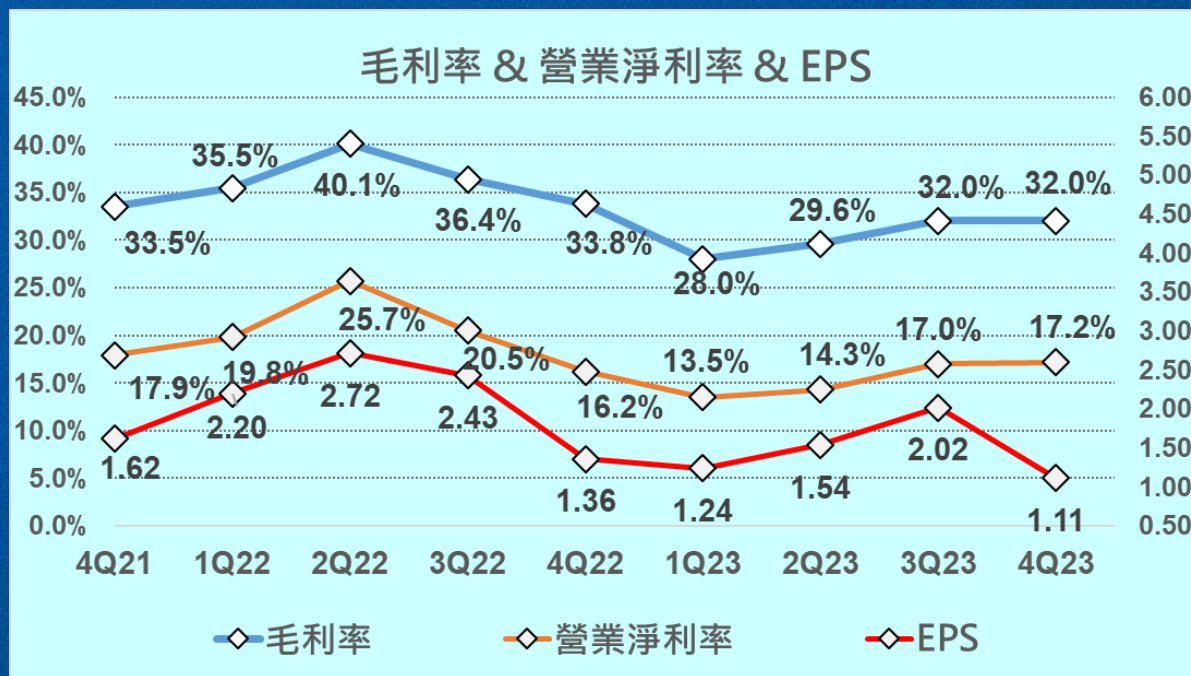
2023 第四季營運概況 (合併財報)

- 4Q23合併營收 15.9億TWD, QoQ -3.3%, 毛利率32.0%(+0 ppt), EPS=1.11。
 - 受第四季台幣升值之影響，外幣兌換與評價減少約六千六百萬台幣。
- 2023合併營收 63.8億TWD, YoY -7.6%, 毛利率30.4%(-6.2 ppt), EPS=5.91

Accounting Period Income (all in thousands TWD except *)	4Q23	3Q23	1Q~4Q23	1Q~4Q22	4Q23 over 3Q23	2023 over 2022
*Net Revenue(USD thousand)	49,967	52,213	204,882	232,701	-4.3%	-12.0%
Net Revenue	1,594,441	1,648,890	6,380,904	6,907,619	-3.3%	-7.6%
Gross Margin	32.0%	32.0%	30.4%	36.6%	+0 ppt	-6.2 ppt
Operating Expenses	(236,747)	(248,188)	(952,994)	(1,097,687)	-4.6%	-13.2%
Operating Margin	17.2%	17.0%	15.5%	20.7%	+0.2 ppt	-5.2 ppt
Non-Operating Items	(71,685)	92,007	71,168	126,561	(163,692)	(55,393)
Net Income to Shareholders of the Parent Company	159,960	292,100	852,122	1,247,391	-45.2%	-31.7%
Net Profit Margin	10.1%	18.0%	13.5%	18.5%	-7.9 ppt	-5.0 ppt
EPS	1.11	2.02	5.91	8.71	-45.0%	-32.1%
ROE	10.2%	19.3%	13.7%	22.9%	+9.1 ppt	-9.2 ppt
Exchange Rate for Evaluation	30.71	32.27			-4.8%	

4Q23 毛利率/營業淨利率/EPS

- 毛利率32.0% (+0 ppt), 營業淨利率17.2%(+0.2ppt), EPS=1.11





4Q23 各事業部及子公司營收

ABU: 砂輪事業部

DBU: 鑽石事業部

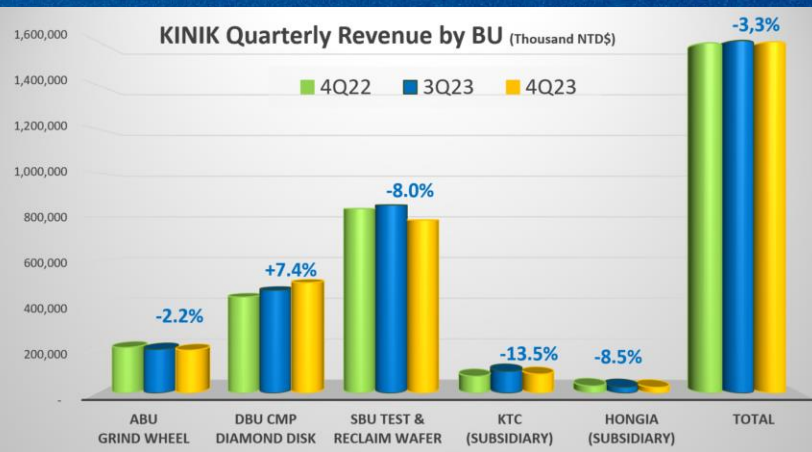
SBU: 晶圓事業部

KTC: 泰國子公司(砂輪)

Hongia: 台灣子公司鴻記工業(砂輪)

- 全公司: 第四季營收受台幣升值影響, 季減3.3%。較去年同期 +0.3%。
- ABU: 工具機及機械業等客戶砂輪需求持平, 季減 2.2%。
- DBU: 鑽石碟客戶成熟製程需求緩步回升, 季增 7.4%
- SBU: 再生及測試晶圓持續產能滿載, 受部分產品ASP下跌以及匯率影響, 營收季減8%

Business Unit	4Q22	3Q23	4Q23		QoQ	YoY
ABU Grind Wheel	206,905	199,366	194,905	12%	-2.2%	-5.8%
DBU CMP Diamond Disk	436,052	467,168	501,685	31%	7.4%	15.1%
SBU Test & Reclaim Wafer	837,550	854,139	785,569	49%	-8.0%	-6.2%
KTC (Subsidiary)	76,517	99,852	86,414	5%	-13.5%	12.9%
Hongia (Subsidiary)	32,283	28,365	25,942	2%	-8.5%	-19.6%
Total	1,589,307	1,648,890	1,594,513	100%	-3.3%	0.3%





1Q~4Q23 各事業部及子公司營收

ABU: 砂輪事業部

DBU: 鑽石事業部

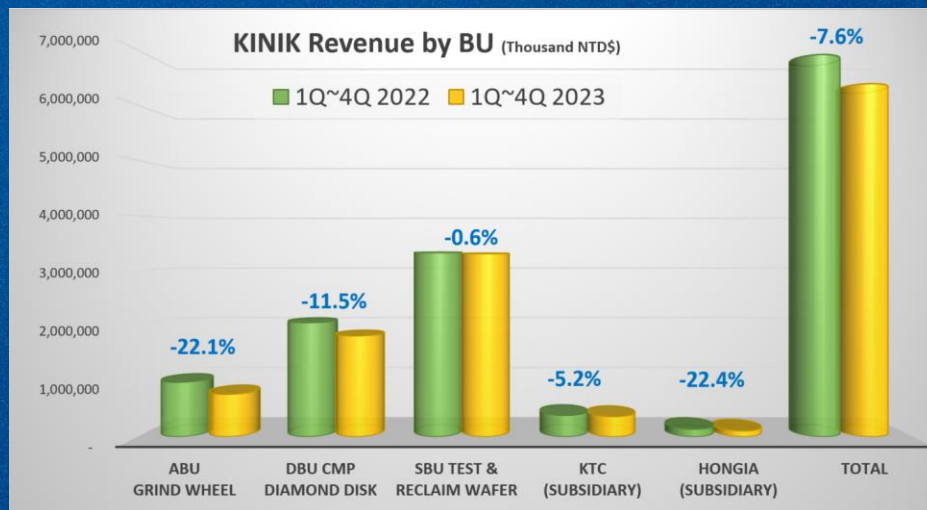
SBU: 晶圓事業部

KTC: 泰國子公司(砂輪)

Hongia: 台灣子公司鴻記工業(砂輪)

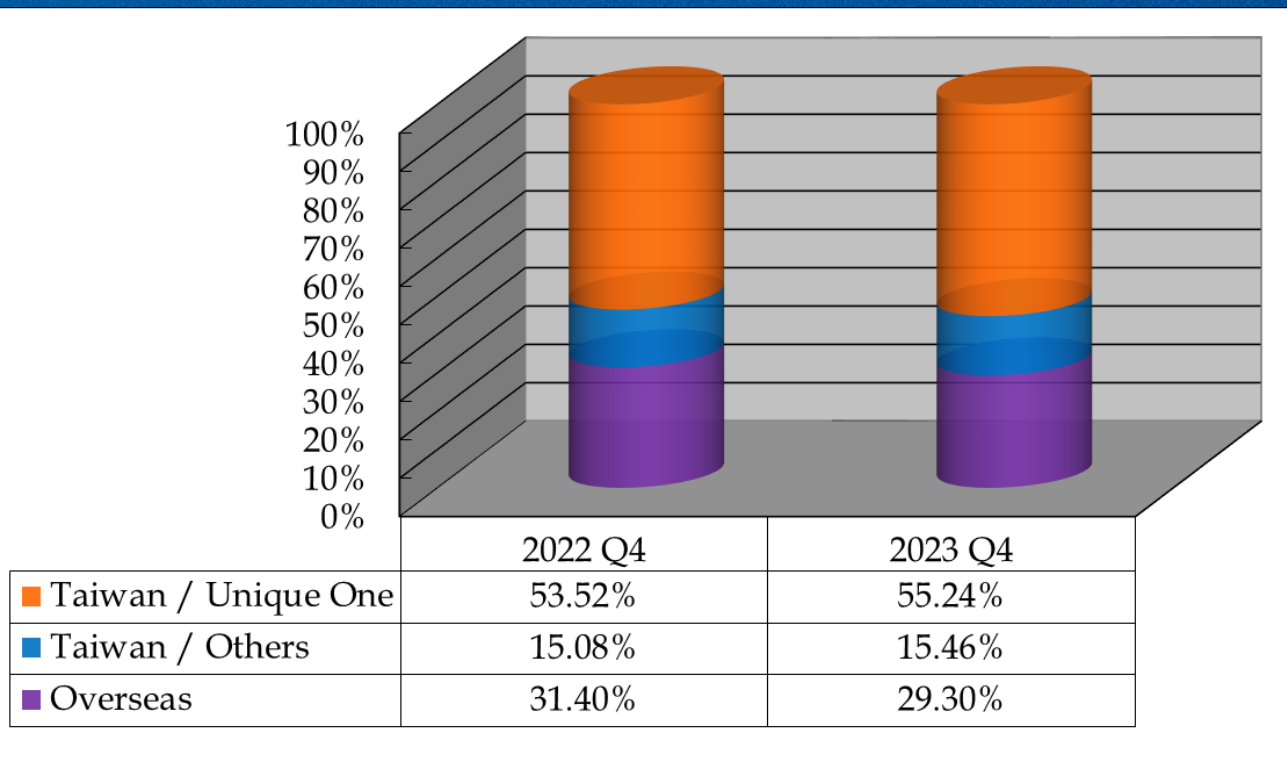
- 全公司: 2023年營收 YoY -7.6%.

Business Unit	1Q~4Q 2022	1Q~4Q 2023		YoY
ABU Grind Wheel	987,367	769,149	12%	-22.1%
DBU CMP Diamond Disk	2,063,549	1,825,729	29%	-11.5%
SBU Test & Reclaim Wafer	3,327,780	3,308,944	52%	-0.6%
KTC (Subsidiary)	388,510	368,178	6%	-5.2%
Hongia (Subsidiary)	140,412	108,904	2%	-22.4%
Total	6,907,619	6,380,904	100%	-7.6%



4Q23 鑽石碟營收表現(1/2)

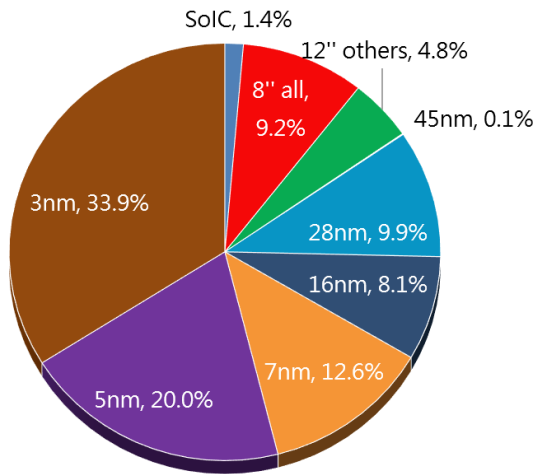
國內外客戶鑽石碟營收百分比



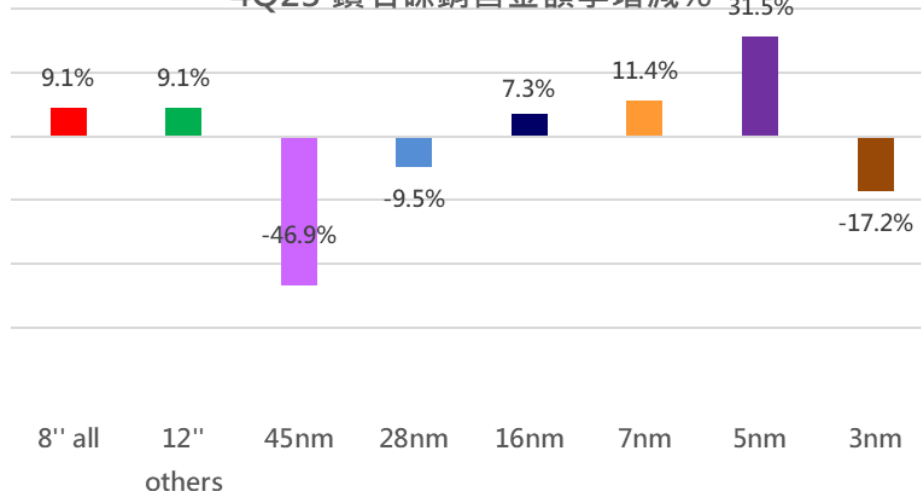
4Q23 鑽石碟營收表現(2/2)

- 4Q23 先進製程產品(5奈米以下)營收占比由上一季56%微幅減少至54%
- 5奈米鑽石碟銷售+31.5%，3奈米鑽石碟銷售 -17.2%.

4Q23 鑽石碟銷售比例 (台灣單一最大客戶)



4Q23 鑽石碟銷售金額季增減%



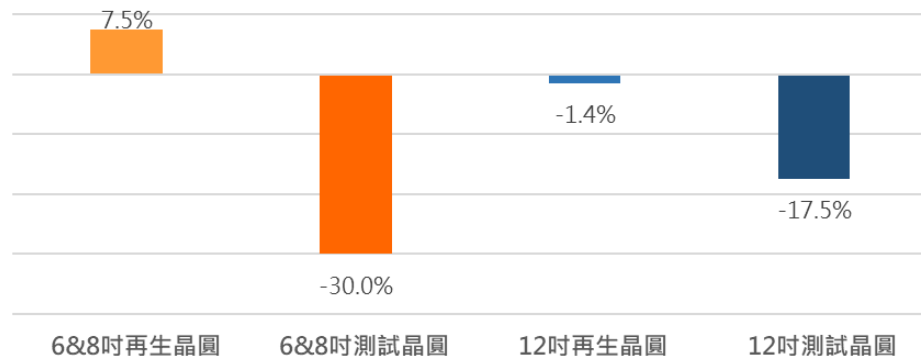
備註：資料對象為國內單一指標客戶。



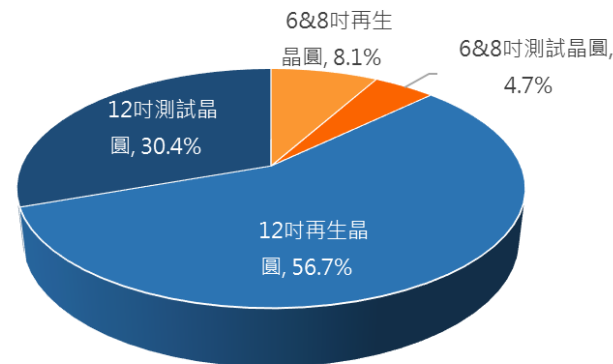
4Q23 晶圓事業部產品別分析

- 4Q23 晶圓事業部整體營收 7.86億, QoQ -8%.
- 受測試晶圓ASP下跌影響，營收比重 35.1% (QoQ -5 ppt).

4Q23晶圓銷售季增減%



4Q23 晶圓事業部產品營收比例



近期重要事件摘要

- 爰依本公司「一〇七年員工認股權憑證發行及認股辦法」以及「一〇九年員工認股權憑證發行及認股辦法」之規定辦理，於112年10月1日起至 112年12月31日止已執行21,000股及230,250股，認股價格為每股新台幣56.1以及58.6元，募得資金共計新台幣14,670,748元，增資後實收資本額為新台幣1,449,435,000元。擬訂定員工認股權憑證112年第四季發行新股增資基準日為113年2月27日。
- 112年2月27日董事會通過112年盈餘分配股東紅利現金每股2.5元，以及資本公積發放每股1.5元，合計4元/股，共計580,082,000元，本案俟股東常會通過後授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 本公司113年股東常會擬訂於民國113年6月24日(星期一)上午九時整，假本公司鶯歌廠員工餐廳(新北市鶯歌區中山路64號)召開實體股東會。

- ◆ 全公司: 對美元匯率31.5之基礎, 預估營收成長 YoY 0~+10%, 毛利率32~38%. 營業淨利率預估16~22%.
- ◆ ABU 砂輪事業部:
 - 2024年傳產及機械工具機客戶需求緩步回升中, 銷售將較2023高個位數至十位數成長。
- ◆ DBU 鑽石事業部
 - 大客戶之先進製程所用鑽石碟的出貨預期逐季增加, 加上邏輯成熟製程及記憶體客戶之產能利用率預期將高於2023, 2024年底前之單月鑽石碟將有機會超過3萬五千顆, 預期DBU之年銷售成長將超過15%, 為成長最高之事業單位。
- ◆ SBU 晶圓事業部:
 - 2024年測試及再生晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片維持不變, 預估全年產能持續滿載.
 - 受2024年矽晶圓供給大於需求, 中砂測試晶圓平均單價較2023平均下跌5%之影響, 預估2024年營收為個位數減少至持平。

Q & A

報告完畢
敬請指教

中砂投資人服務信箱
ir@kinik.com.tw

附件

- ◆ 中砂經營理念
- ◆ 中砂產品介紹
- ◆ 各廠區資訊
- ◆ 榮耀記事



企業經營理念使命與願景

Business philosophy
Good together

Good to You, Me, All

經營
理念
共
好

你好，我好，大家好

使
命

Mission

Keep creating innovative values
for industries and customers.

精益求精為產業
與客戶創新價值

Vision

願
景

成為研磨解決方案的
卓越智造與服務中心

Become an excellent and intelligent
smart manufacturing and service center
for grinding solutions.

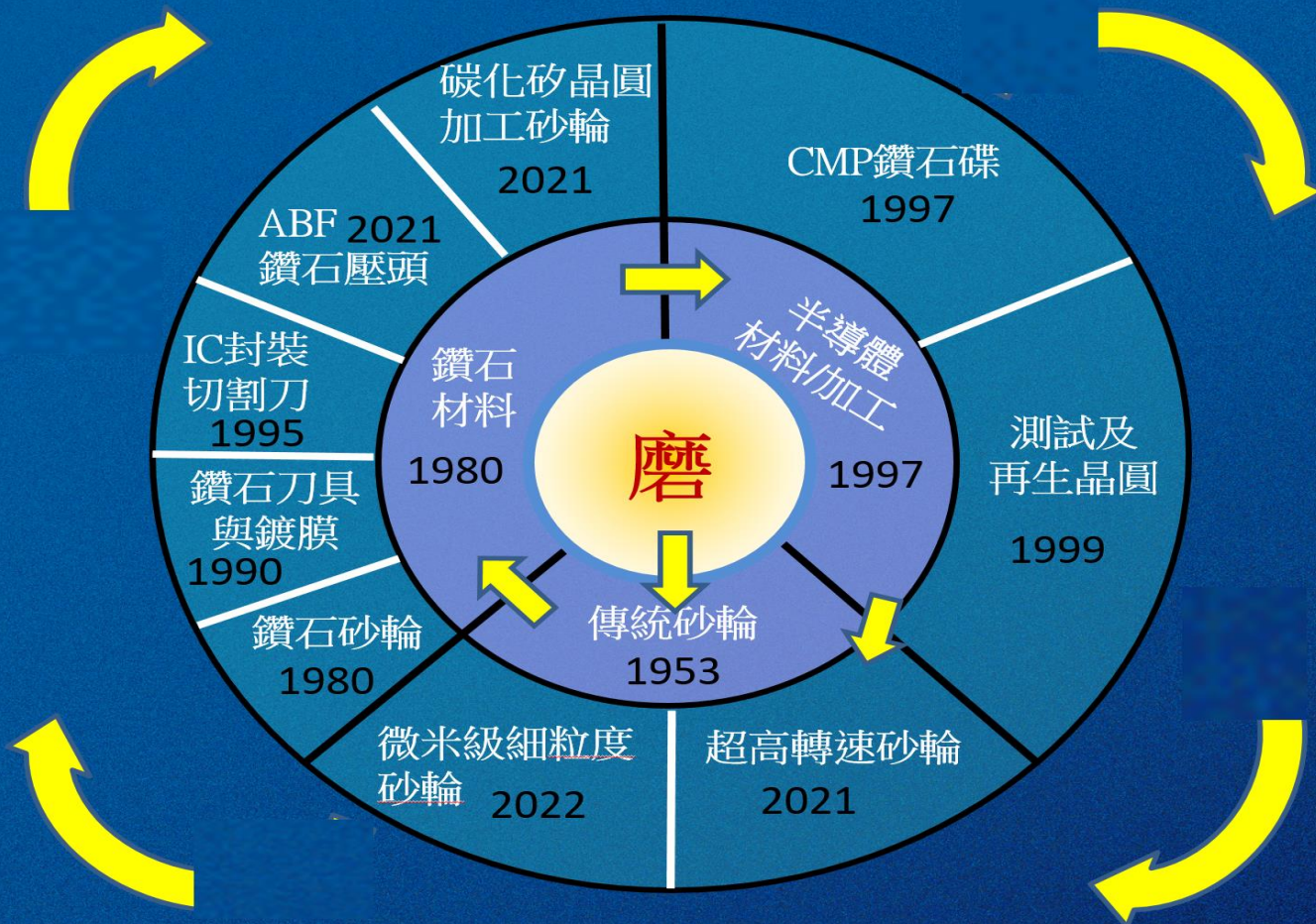


從磨石頭到磨半導體 中砂的70年成長之路與未來展望



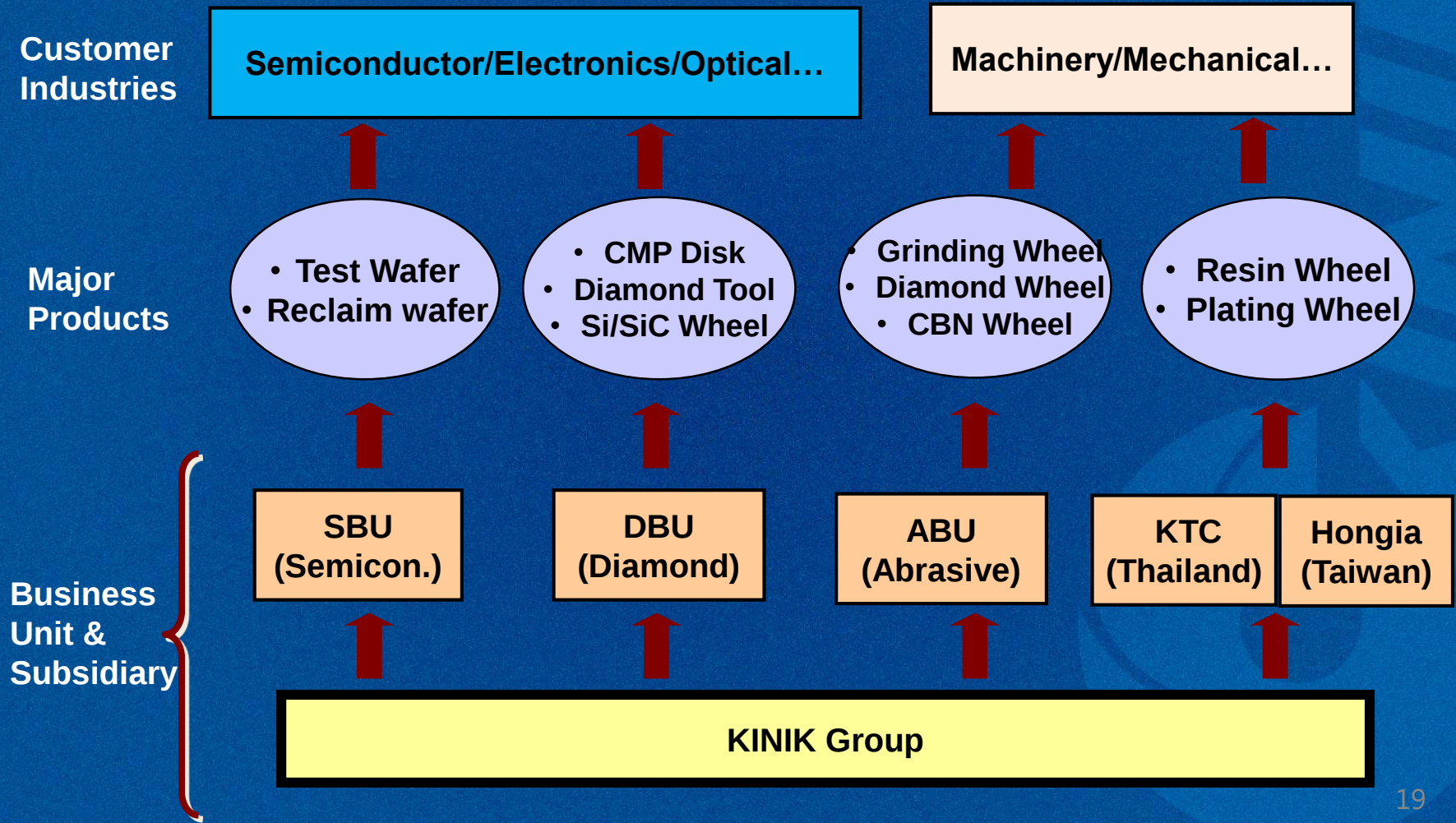


以「磨」為核心提供各產業所需產品



循著砂輪的旋轉軌跡不斷前進

Major Product and Business Diagram



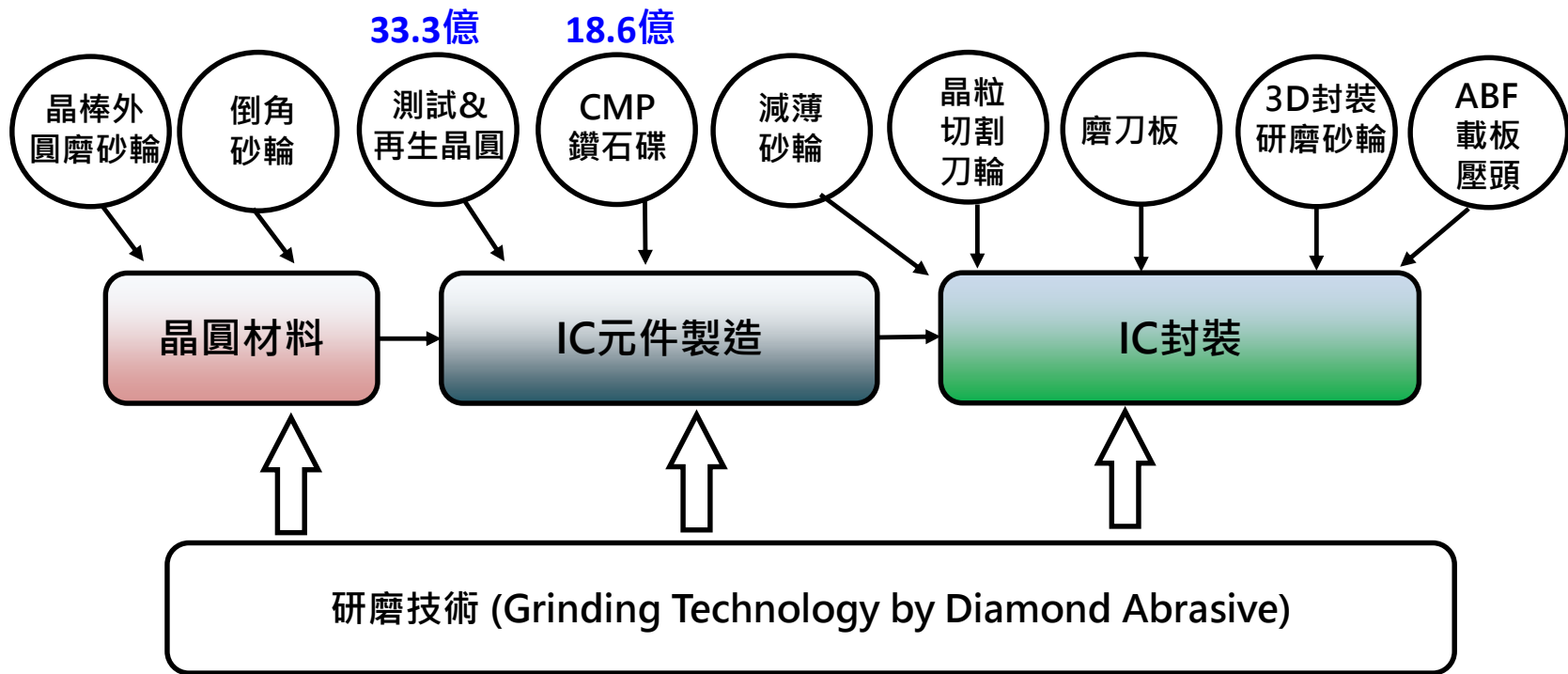


中砂產品介紹

Products Introduction

中砂研磨產品在半導體製程的角色

單位：2022年營收新台幣



2022年中砂在半導體相關產業的營收53.3億元，佔KINIK合併營收約77%，且毛率41%(5%高於2022全部產品的平均36%)

What is test and reclaim wafer?

The source of the reclaimed wafers comes from the monitor wafers and the dummy wafers but not the defect wafers manufactured by the semiconductor fab. The services we provide to refurbish these reclaimed wafers can dramatically lower the running cost of a semiconductor manufacturer.

The reclaimed wafers can be categorized according to functions as figure 1 and the reclamation system is shown as figure 2.

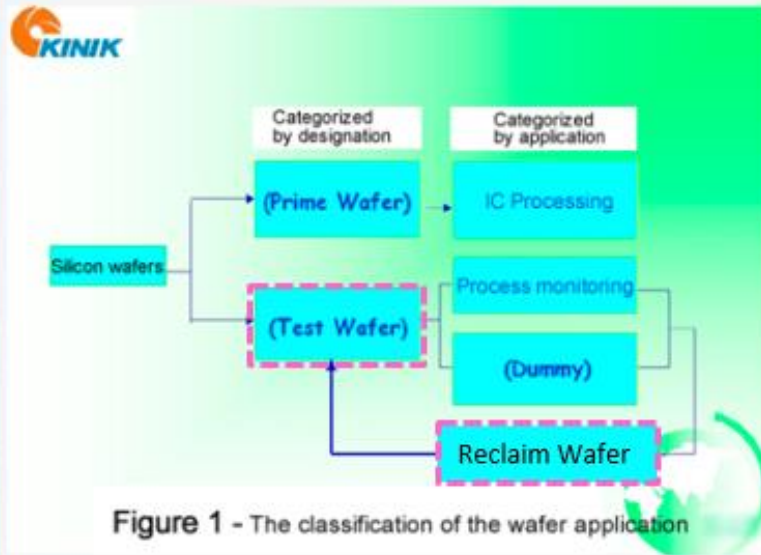


Figure 1 - The classification of the wafer application

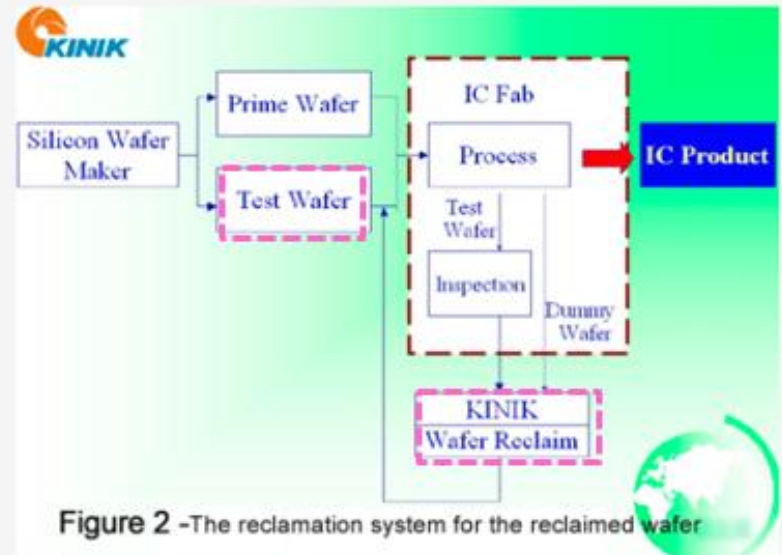


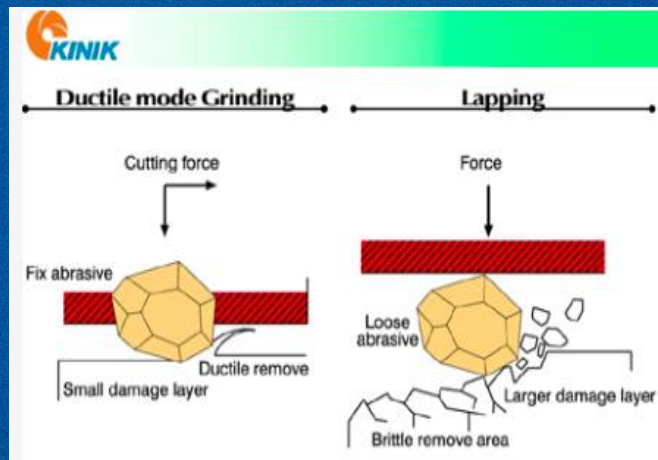
Figure 2 -The reclamation system for the reclaimed wafer



測試/再生晶圓 Test/Reclaim Wafer

中砂的測試與再生晶圓之製程特色以延性輪磨(Ductile Mode Grinding)加工取代傳統研磨(Lapping)加工，目的是降低加工之變質層，減少化學藥品污染，且可提高加工精度，為最先進之再生晶圓製程。

The features of the KINIK's test and reclaimed wafers are processed by ductile mode grinding used to replace traditional lapping to lower the damaged thickness on the surface and for less chemical contamination. The ductile mode grinding is the leading-edge process for the high precious reclaimed wafers.

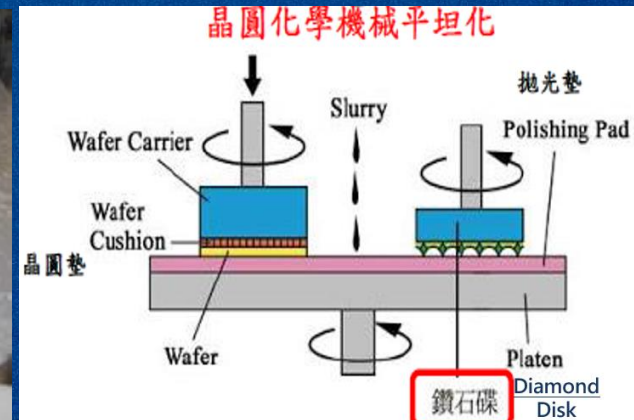
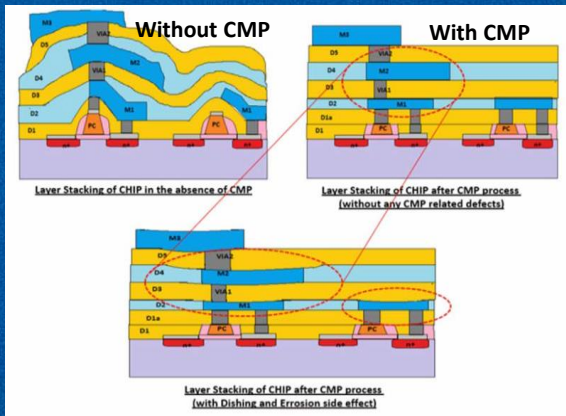




CMP 鑽石碟 Diamond Disk

CMP (Chemical Mechanical Polish) 化學機械拋光，主要用於先進IC製程中，透過拋光墊與拋光液同時透過機械與化學反應加工晶圓表面，達到表面晶圓材料的移除及整體的平坦化，才能接續後續製程以及提高良率，進而能循摩爾定律持續微縮IC線寬面積，推展出N5/N3/N2先進製程。而**鑽石碟**的功用就是在拋光晶圓的同時去加工拋光墊，以移除拋光時的副產物及穩定拋光速率並提升良率及延長拋光墊使用壽命，是先進IC拋光製程中提升良率及控制成本中非常重要的一環。

CMP (Chemical Mechanical Polish) is widely used for advanced IC manufacturing processes for surface material removal, smoothing surfaces, and planarization by the polish pad (mechanical) and the abrasive slurry (chemical reaction). And the **diamond disk (aka pad conditioner)**'s function is to in-situ dress the polish pad during the process to remove the polish byproduct, to maintain a stable pad roughness and remove rate, to improve yield, and to prolong the lifetime of the pad.





CMP 鑽石碟 Diamond Disk

中砂鑽石碟用於半導體化學機械研磨製程中修整研磨墊以達到理想移除率及平坦度。

KINIK diamond disk is used on semi-conductor CMP process in order to make the pad reach the desirable removal rate and uniformity.

Conventional Disk



DiaGrid®



I-DiaGrid®

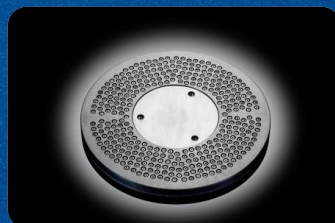


S-DiaGrid®

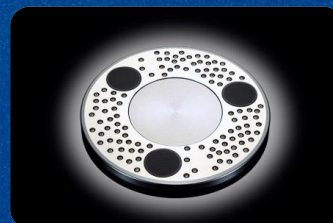
Advanced Disk : High Performance / Long Life Time



Pyradia®



O-Pyradia®
(Metal Free)



CVD Hybride

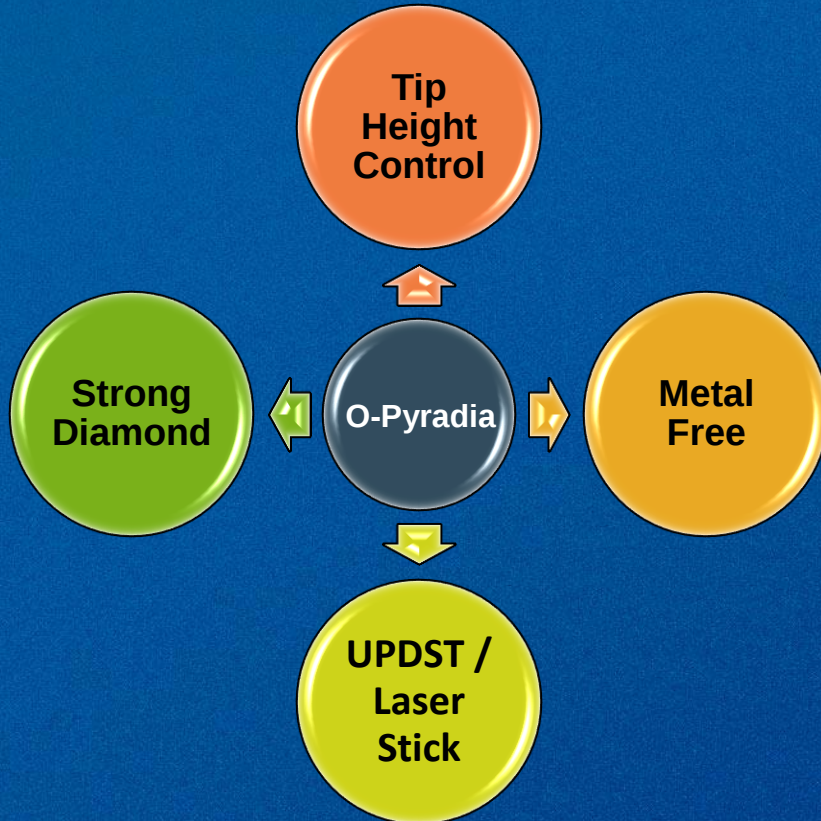


CVD-WAVE



Metal-free O-Pyradia® 鑽石碟

- O-Pyradia CMP pad conditioner for advanced customer's tightened metal contamination control.



Pyradia Type	O-Pyradia	Pyradia
Photo		
Material of Substrate	Polymer	Metal
Bonding Material	Polymer	LM(Ni ; Cr powder)
Bonding Strength	+	++
Process Temp	<100 degree	~1000 degree
Diamond Strength	++	+
Acid and alkali resistant	Metal Free	Ni ; Cr

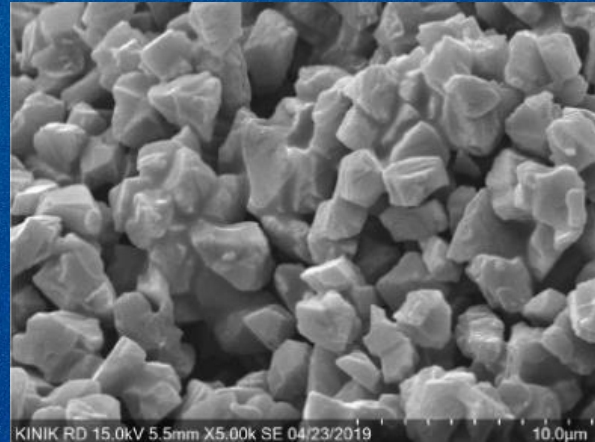


Wafer Grinding Wheel

- 中砂的晶圓研磨砂輪可用於矽晶圓加工、IC封裝(WLP/PLP/2.5D/3D)、碳化矽、藍寶石及再生晶圓等硬脆材料的直立式進給研磨加工應用。直立式進給的晶圓研磨加工一般包括粗及細研磨製程，可依客戶加工需求，來客製化設計陶瓷結合劑，鑽石磨料及微結構組織。晶圓研磨砂輪的鑽石粒度一般為#325 ~ #1000及#2000 ~ #8000。其特色為有穩定的高材料移除率、長效使用壽命及低研磨阻抗電流等優點。



晶圓研磨砂輪



孔隙微結構組織

鑽石滾輪

- 鑽石滾輪乃應用於複雜形狀且高精度之成形研磨砂輪的修整(例如氧化鋁, 碳化矽, 氮化硼cBN砂輪), 適用於例如滾珠螺桿、滑軌、軸承、齒輪、刀治具、汽車及航太零件等產業之精密元件, 於成形或創成批量產研磨加工時維持砂輪形狀精度的自動化修整作業。
- 鑽石滾輪是利用天然/人造或CVD鑽石, 以反轉電鑄或滲透燒結等製法來製作而成, 鑽石採隨機或規則性的排列, 具有高形狀精度及高修整效率等特色, 我們可依客戶需求提供適用於各式不同磨床機台與成形研磨加工應用的各製法鑽石修整滾輪。



滾珠螺桿成形砂輪修整用鑽石滾輪



半導體及光電業工具

Semiconductor & photoelectric Tool

中砂以最新電鑄、成型與燒結技術製造成的精密鑽石切割刀。搭配特殊的金屬與樹脂等結合劑，使切割軟刀具備高剛性、低磨耗且具備良好的自銳性；適合在各類精密陶瓷、硬脆材料、磁性材料，光學玻璃，印刷電路板與半導體封裝材料的切割應用。

KINIK Company announces the introduction of Super Hubless Dicing Blade with resin, metal and nickel matrices. The dicing blades are manufactured by specialty consolidation, sintering and electro-forming process that improve the uniformity of the thin blades. They are suitable for cutting ceramics, brittle materials, optical glass, printed circuit boards, especially for semiconductor packaging.



鑽石切割軟刀 Dicing Blade



磨刀板 Dressing Board



半導體及光電業工具

Semiconductor & photoelectric Tool

多孔質陶瓷真空吸盤

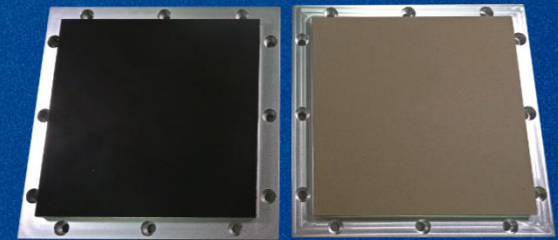
Porous Ceramic Chuck Table

多孔質陶瓷孔洞均勻微細、不發塵、可具靜電消散特性，應用於真空吸盤具備吸力均勻、局部吸附性、不產生印痕、工作效率及精度高等優點，可充分應用於半導體研磨、清洗、切割及檢測等設備。

- High-performance, High-precision, Uniform suction force.
- Partial chucking without sagging.
- Chucking and transport of wafer without leaving suction marks.
- Produces no static electricity and dust.

Application :

Wafer grinder, cleaning/dicing machine and measuring equipment, etc.





精密加工PCD刀具

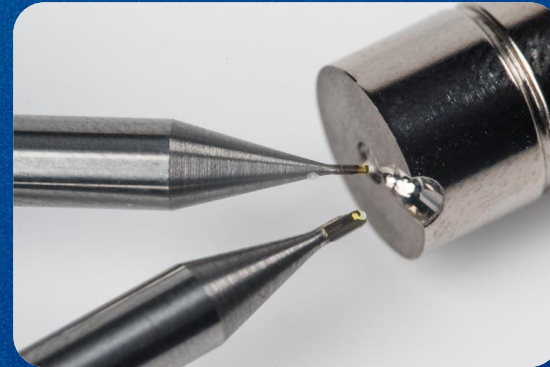
Ultra Precision Machining Tools

中砂提供電子業、PCB板、木工業及金屬加工業所需的單晶（SCD）、聚晶鑽（PCD）、立方氮化硼（PcBN）等鑽石刀具已逾20年。

近年積極投入生產高精度、更微小之SCD、PCD 及 PcBN產品供光學業、精密模具等加工技術使用，如：單晶鑽石車刀與銑刀、PcBN微小徑銑刀等。

KINIK company already has more than 20-year experience in providing all kinds of diamond tools for the applications of PCB, woodworking and metal working industries.

Recently, KINIK also developed several kinds of SCD, PCD and PcBN precision micro tools to meet high-end market's requirements.



加工面達到極高的光潔度表現。
High finish at processing parts.



PVD/CVD 鍍膜

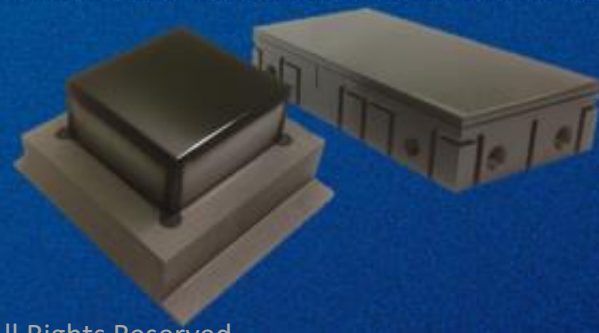
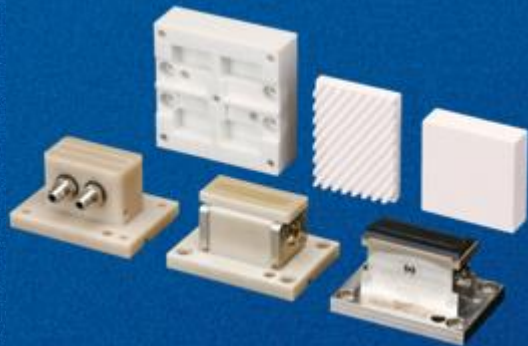
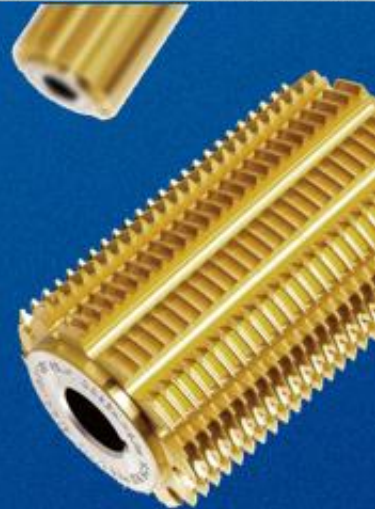
PVD/CVD Coating Service

中砂鍍膜代工中心2000年成立，在PVD/CVD真空鍍膜領域深耕近20年，不斷投入相關鍍膜設備及開發TiN、TiCN、TiAlN、DLC、Diamond鍍膜技術等。同時持續將研究成果應用至各個產業，提供給客戶高效能的鍍膜應用工具，包括機械加工、精密模具、3C產品、汽車、通訊、醫療、光學及電子產業等。

Established in 2000, KINIK Coating Center has 20 years of experiences in PVD/CVD coating.

KINIK persistently invests in the development of PVD/CVD equipment and coating technologies of TiN, TiCN, TiAlN, DLC and Diamond etc.

KINIK provides these high-performance, hard films coated tools for customers in various industrial applications, including machining tools, precision molds, 3C products, automobiles, communication, medical, optical, electronics and so on.





傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel

中砂提供各式平面、內外圓、無心及雙平面等工件研磨及切斷用的傳統、BD及電鑄砂輪。

主要產業應用包含精密機械業的滑軌及齒輪研磨與砂輪成形修整用的鑽石滾輪、鋼鐵業的軋筒研磨、工具製造業的高速鋼鑽頭、CNC及PCD/PcBN刀具等研磨、半導體業的晶圓減薄及倒角研磨、高效率硬脆材料如SiC研磨用的蜂巢砂輪、光學模具模仁拋光等。

KINIK provides various grinding wheels for surface, internal & cylindrical, centerless and disc surface grinding and cutting of workpiece production. The main industrial applications include linear guideway, gear grinding and diamond roller for dressing wheel in precision machinery, steel roll grinding, HSS drill, CNC & PCD/PcBN tool grinding, wafer thinning and edge grinding in semiconductor, honeycomb wheel for high-efficient grinding of hard and brittle materials such as SiC, optical mold polishing etc.

傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel



平面研磨
Surface Grinding



外圓研磨
Cylindrical Grinding



輥筒研磨
Roll Grinding



滑軌成形研磨
Linear Guideway Grinding



雙平面研磨
Disc Surface Grinding



齒輪研磨
Gear Grinding



傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel



光學模仁拋光
Optical Mold Polishing



內圓研磨
Internal Grinding



CNC刀具研磨
CNC Tools Grinding



蜂巢砂輪
Diamond & CBN Honey Comb Wheel



PCD刀具研磨
PCD Cutting Tools Grinding



傳統砂輪及鑽石/CBN砂輪

Traditional Grinding Wheel & Diamond / CBN Grinding Wheel



電鑄砂輪
Electroplated Diamond & CBN Wheels
and Products



各式切斷及可彎曲、碟式砂輪
Cut-off, Depressed & Flexible Wheels, and
Flap Disc



鑽石滾輪
Diamond Roller



砂輪動平衡校正儀
Grinder Balancer



廠區 Plant



總公司 Head Office 鶯歌廠區 Yingge Factory

239010 新北市鶯歌區中山路64號
No.64, Zhongshan Rd., Yingge Dist.,
New Taipei City 239010, Taiwan
TEL:+886 2 2679-1931~40

Grinding Wheel & Diamond Disk



樹林廠區 Shulin Factory

238010 新北市樹林區中山路2段151巷16號
No.16, Ln. 151, Sec. 2, Zhongshan Rd.,
Shulin Dist., New Taipei City 238010, Taiwan
TEL:+886 2 8684-4111~13

Diamond Disk
Diamond Cutting & Dicing Tools



新竹廠區 Hsinchu Factory

303035 新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路6號
No.6, Wenhua Rd., Hukou, Hsinchu Ind.
Park, Hsinchu County 303035, Taiwan
TEL:+886 3 598-4990

Diamond Dicing Tools. PVD Coating
Ceramic Vacuum Chuck





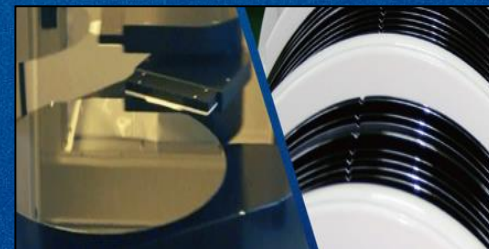
竹北廠區 Zhubei Factory

302059 新竹縣竹北市十興路260號
No.260, Shixing Rd., Zhubei City,
Hsinchu County 302059, Taiwan
TEL:+886 3 550-7160~5



竹科廠區 Hsinchu Science Park Factory

350401 苗栗縣竹南鎮科北五路6號
No. 6, Kebei 5th Rd., Jhunan
Township, Miaoli County 350401,
Taiwan
TEL:+886 3 550-7160



Reclaim & Test Wafer
再生晶圓 & 測試晶圓



廠區 Plant



鴻記工業股份有限公司

Hongia Industry Co, Ltd.

239018 新北市鶯歌區福安街7巷3號
No. 3, Lane 7, Fu-An St., Yingge Dist.,
New Taipei City 239018, Taiwan

TEL:+886 2 2679-1006

Email : hongia-sale@kinik.com.tw

www.hongia.com.tw



Electroplated Diamond
Wheel 電鑄砂輪



金力泰國有限公司

Kinik - Thai Co., Ltd.

225 Moo 7, Khok Pip, Simahosot,
Prachinburi 25190 Thailand
TEL:+663 727 6954

Email : sales@kinikthai.co.th

www.kinikthai.co.th



Resin and Ceramic Wheel
樹脂砂輪&陶瓷砂輪

榮耀記事 Milestone



2021年11月榮獲行政院「第26屆國家品質獎 全面卓越類 - 績優經營獎」。

Nov. 2021, Honored with "BUSINESS MERIT AWARD of Total BUSINESS EXCELLENCE" at the 26th NATIONAL QUALITY AWARD from the Executive Yuan, R.O.C.

https://nqa.cpc.tw/NQA/Web/Awards26th_Content.aspx?p=f2b6e812-92aa-49c3-8149-1e005a0fe706

賀!中國砂輪公司榮獲「第26屆國家品質獎」



經濟部 林全能次長(左)、中國砂輪公司 林伯全董事長(右)。圖/經濟部工業局提供。

中國砂輪公司 榮獲「第26屆國家品質獎」，林伯全董事長受邀晉見總統



中國砂輪公司董事長 林伯全(右)、總統 蔡英文(左)。圖/總統府提供



2021年10月榮獲經濟部「2022年第30屆台灣精品獎 - 12吋再生晶圓」。

Oct. 2021, Honored with "Taiwan Excellence Award - 12" Reclaimed Wafers" from the MOEA, R.O.C.

<https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/product/1110433>



TAIWAN EXCELLENCE

得獎產品：12 inches Reclaim Wafer



榮獲經濟部第四屆卓越中堅企業獎

Honored with 4th Taiwan mittelstand Award from the MOEA, R.O.C, in 2017.



榮獲經濟部2013年 第14屆 工業精銳獎 機械、運輸工業類

Honored with 14th Industrial Sustainable Excellence Award from the MOEA, R.O.C, in 2013.

TOP 100
TAIWAN BRANDS



榮獲經濟部台灣百大品牌獎

Honored with the Top 100 Taiwan Brands Award from the MOEA, R.O.C, in 2011.



榮獲經濟部2006年台灣優良品牌獎

Honored with the Taiwan Superior Brand Award from the MOEA, R.O.C, in 2006.



榮獲第十屆經濟部產業科技發展傑出獎

Award of Excellence, the 10th R.O.C. MOEA Industrial Technology Advancement Award in 2002.



全國第一家砂輪公司榮獲國家傑出精品獎

The first grinding wheel plant won Excellent Product Award in 1993.